

Principaux équipements disponibles à Nanofab

Lithographie optique

- Un aligneur lithographie par contact [MJB3 lampe UV](#) - 2"
- Un aligneur lithographie par contact [MJB3 lampe DUV](#) - 2"
- Lithographie par projection (microscope optique modifié)
- Lithographie Laser - [Heidelberg DWL66FS](#)
- Insolateur 4" Kub Kloé

Lithographie électronique et FIB

- Un [MEB](#) Léo 1530 (FESEM) piloté par un system RAITH Elphy plus et équipé d'une colonne FIB Orsay Physic

Etallements résines

- Deux [hottes](#) équipées de Spin coater, Hot plate, Eau DI ...

Dépôts métalliques

- Evaporateur par canon à électrons [PLASSYS](#)- 8 creusets- 2 "
- Deux évaporateurs thermiques [Edwards- 2"](#)
- Pulvérisation DC/RFAAlliance Concept, DP850

Dépôts isolants

- [Pulvérisation RF](#) - 2"
- [ALD](#) 4" (Al₂O₃, HfO₂, ...)

Activation de surface

- Equipement de Silanisation/activation de surface

Gravures

- RIE [PLASSYS](#) (SF₆, CHF₃, O₂) - 4"
- [IBE PLASSYS](#) (Ar) avec SIMS - 2"
- Gravure HF gazeux- 2"
- Gravure anisotrope Si- 2"
- Gravure isotrope du Silicium XeF₂

Caractérisations/ Back-End

- MEB Zeiss Ultra plus (FESEM) équipé EDS Brucker SDD
- Microscopie optique
- [Profilomètre Mécanique Veeco 6M](#)
- Interféromètre optique spectroscopique Idil Nanocalc
- [Contrôle sous pointes](#)
- Un équipement de [clivage](#)
- Deux Microsoudeuses à Ultrasons [West Bond](#) - Fils Au et Al